

기술 2024-119

2024.08.08.

이 보고서는 시가총액 5,000억 원 미만의 중소형 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서 일반전기전자

텔레칩스(054450)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 (주)NICE디앤비

작성자 고준혁 연구원

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브(IRTV)로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2122-1300)로 연락하여 주시기 바랍니다.

텔레칩스(054450)

차량용 반도체 설계 전문 팹리스 업체

기업정보(2024.08.01. 기준)

대표자	이장규
설립일자	1999년 10월 29일
상장일자	2004년 12월 10일
기업규모	중견기업
업종분류	전자집적회로 제조업
주요제품	디지털 미디어 프로세서 등

시세정보(2024.08.01. 기준)

현재가(원)	17,290원
액면가(원)	500원
시가총액(억 원)	2,618억 원
발행주식수	15,144,233주
52주 최고가(원)	38,550원
52주 최저가(원)	16,710원
외국인지분율	0.00%
주요주주	
이장규	20.00%
(주)엘엑스세미콘	10.00%

■ 차량용 반도체 설계를 전문으로 수행하는 팹리스 업체

텔레칩스(이하 동사)는 1999년 10월 설립되었으며, 2004년 12월 코스닥 시장에 상장한 업체이다. 동사는 차량용 인포테인먼트 AP칩의 설계 공급, 디지털 멀티미디어 프로세서 등의 자동차용 반도체의 설계 및 공급을 수행하는 팹리스 업체로 국내·외 판매 네트워크를 바탕으로 제품을 판매하고 있다.

■ 연구개발 역량이 중요한 팹리스 산업, 반도체 시장과 함께 성장 전망

반도체 팹리스 업체는 반도체 제조 시설을 보유하고 있지 않아, 비교적 제품개발 및 마케팅 등에 집중할 수 있는 장점을 보유하고 있다. 다만, 핵심 원천기술 등의 연구개발 및 고객 맞춤형 수요 대응 등이 부담으로 작용하는 산업이다. 한편, ADAS, 자율주행 등 다양한 분야에 적용되는 제품 및 기술의 발전에 따라 차량용 반도체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 글로벌 차량용 반도체 시장 규모는 2023년 760억 달러에서 연평균 11.11% 성장하여 2027년 1,158억 달러 수준이 될 것으로 전망된다.

■ 글로벌 네트워크 및 연구개발 역량 기반 해외 매출 확대 추진

동사는 홍콩, 미국, 상해, 심천 등 다양한 해외법인을 설립해 글로벌 네트워크를 바탕으로 해외 매출 확장을 위한 기반을 다지고 있다. 또한, 최근 협력업체 사피온의 NPU IP 공급을 바탕으로 AI 가속기 제품 관련 연구개발을 수행하는 등 글로벌 시장 요구에 발맞춘 제품 연구개발을 수행하고 있다. 이처럼, 동사가 보유한 글로벌 네트워크, 제품 경쟁력 등을 바탕으로 해외 매출 확대를 추진하고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2021	1,364.1	35.4	80.8	5.9	70.3	5.2	7.1	3.8	95.0	521	8,453	33.4	2.1
2022	1,504.0	10.3	91.8	6.1	459.0	30.5	33.3	17.7	82.8	3,349	12,418	3.3	0.9
2023	1,910.9	27.1	167.8	8.8	626.4	32.8	30.1	18.3	52.2	4,297	16,679	7.8	2.0

기업경쟁력

높은 수준의 연구개발 투입 지속 및 협력을 통한 설계역량 강화

- 2023년 기준 매출액 대비 34.3%의 높은 연구개발비 비중 등 R&D 역량 보유
- 반도체 설계자산(IP) 및 디자인하우스 업체와의 협력을 통한 제품 설계 역량 강화

다양한 국내·외 영업 네트워크 보유

- 홍콩, 미국, 상해, 심천 등 다양한 해외법인 보유

주요 제품 및 특징

차량용 인포테인먼트용 AP

- AVN(Audio, Video, Navigation), Digital Cluster 및 Cockpit용 AP 제품
- 돌핀(Dolphin) 시리즈 보유
- CES 2024, 8나노미터 공정을 통해 제조 예정인 수행한 돌핀5 공개

첨단 운전자 보조 시스템용 프로세서

- 다기능 카메라, 운전자 모니터링 시스템, 카메라 미러 시스템 등의 기능을 보유한 자동차용 비전 프로세서
- NPU를 적용한 엔돌핀(N-Dolphin) 등 신제품 보유

동사의 주요 제품



시장경쟁력

글로벌 비메모리 반도체 시장 전망

년도	출하액	연평균 성장률
2023	5,169 억 달러	▲ 8.70%
2027(E)	6,639 억 달러	

글로벌 차량용 반도체 시장 전망

년도	시장규모	연평균 성장률
2023	760.0 억 달러	▲ 11.11%
2027(E)	1,158.3 억 달러	

시장환경

- 글로벌 비메모리 반도체 시장은 고물가, 고금리 등의 영향으로 2022년 대비 2023년 소폭 하락
- 그러나, 글로벌 비메모리 반도체는 꾸준히 수요가 증가하여 시장 또한 성장세를 유지할 것으로 전망
- 글로벌 차량용 반도체 시장은 ADAS, 자율주행 등 기술의 발전으로 꾸준한 수요 증가세 전망
- 반도체 설계 수요의 확대가 예상되어 동사와 같은 팹리스 업체 또한 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상

I. 기업 현황

국내·외 네트워크를 보유하고 있는 차량용 반도체 설계 전문 팹리스 업체

동사는 차량용 인포테인먼트 AP, 디지털 미디어 프로세서 등 자동차용 반도체의 설계 및 공급을 전문으로 수행하는 팹리스 업체로 국내·외 영업 네트워크를 보유하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 1999년 10월 29일 설립되어 2004년 12월 10일 코스닥 시장에 상장하였으며, 멀티미디어와 통신 관련 시장의 다양한 애플리케이션 제품에 필요한 핵심 칩 및 토탈 솔루션의 개발/판매, 차량용 시스템 반도체에 최적화된 팹리스(Fabless) 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 한편, 본사는 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27에 위치하고 있다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

일자	내용
1999.10.	동사 설립 (대표이사 서민호)
2004.12.	코스닥 시장 상장
2014.01.	대표이사 변경 (대표이사 서민호 → 대표이사 이장규)
2016.06.	종속회사 TELECHIPS USA INC. 설립
2016.07.	종속회사 TELECHIPS SHANGHAI CO., LTD. 설립
2019.01.	종속회사 TELECHIPS SHENZHEN CO., LTD. 설립
2022.12.	現 주소지로 본사 이전(경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27)

자료: 동사 분기보고서(2024.03.), 동사 IR자료, NICE디앤비 재구성

주식등의대량보유상황보고서(2024.07.10.) 기준, 동사의 최대주주는 이장규 대표이사로 20.00%의 지분을 보유하고 있으며, (주)엘엑스세미콘이 10.00%, 한국증권금융이 4.36%, 기타주주가 65.64%의 지분을 보유하고 있다. 한편, 동사의 연결대상 종속회사는 5개 사(텔레칩스 홍콩, 미국, 상해, 심천, (주)마인드테크)이며, 지분을 100% 보유하고 있다.

[표 2] 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황

주주명	지분율(%)
이장규 대표이사	20.00
(주)엘엑스세미콘	10.00
한국증권금융(주)	4.36
기타	65.64
합계	100.00

[표 3] 주요 관계사 현황

회사명	주요사업	자산총액(억 원)
TELECHIPS HK LIMITED	반도체 사업 마케팅/서비스	0.8
TELECHIPS USA INC.	반도체 사업 마케팅/서비스	0.2
TELECHIPS SHANGHAI CO., LTD.	반도체 사업 마케팅/서비스	4.1
TELECHIPS SHENZHEN CO., LTD.	반도체 사업 마케팅/서비스	2.5
(주)마인드테크	인공지능 알고리즘/칩 개발	5.5

자료: 동사 주식등의 대량보유상황보고서(약식) 공시(2024.07.10), 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

■ 대표이사 경력

이장규 대표이사는 서강대학교 전자공학 학사, 연세대학교 전자공학 석사 학위를 취득한 후, 삼성전자 메모리 사업부에서 연구개발 직무에서 반도체 관련 현업 경험을 쌓았으며, 1993년 반도체 팹리스 업체인 C&S 테크놀로지를 공동 설립하며 개발실장으로 근무하였다. 이후, 前 대표이사 서민호, 現 대표이사 이장규가 최대주주(각 지분 30.04%)로 동사를 설립하였으며, 이장규 대표이사는 연구소장, 부사장직 등을 거쳐 2014년 1월부터 동사의 대표이사직을 맡고 있다.

■ 주요 사업

동사는 설립 이후 디지털 기반 caller ID Chip, MP3 칩셋 등을 통해 사업을 영위하였으나, 현재는 반도체 설계를 전문으로 수행하는 팹리스(Fabless) 업체이다. 동사는 주로 차량용 인포테인먼트(IVI, In-Vehicle Infotainment)¹⁾에 요구되는 AP(Application Processor) 칩의 설계 및 공급 관련 사업을 영위하고 있다. 특히, 내비게이션, 카오디오, 비디오, 헤드업 디스플레이(HUD, Head Up Display) 등 디지털 미디어 기기에 사용되는 AP를 의미하는 DMP(Digital Media Processor)를 통해 주요 매출을 실현하고 있으며, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems)용 프로세서, 마이크로 컨트롤러 유닛(MCU, Micro Controller Unit) 등의 제품개발도 수행하고 있다.

■ 주요 고객사

동사는 국내·외 고객을 대상으로 영업하고 있으며, 2023년 기준 해외 84.3%, 국내 15.7%의 비중을 차지하고 있다. 주요 고객은 글로벌 완성차 기업인 현대차/기아 및 Tier1 부품사 등이 있으며, 국내 판매는 직접 판매 방식으로, 해외 판매는 대리점 등의 글로벌 네트워크를 바탕으로 간접 판매를 수행하고 있다. 한편, 제품의 생산계획 등을 고려하여 2~3개월 전에 선제적으로 구매주문서를 수령한 뒤 적절한 납기에 맞춰 제품을 공급하고 있다.

[그림 1] 동사의 글로벌 네트워크



자료: 동사 IR자료, NICE디앤비 재구성

1) 차량용 인포테인먼트(IVI, In-Vehicle Infotainment): 인포테인먼트(Infotainment)는 정보를 의미하는 인포메이션(Information)과 오락을 뜻하는 엔터테인먼트(Entertainment)의 개념을 결합한 단어로, 차량용 인포테인먼트는 탑승자에게 주행 관련 정보 및 오락 거리 등을 서비스할 수 있는 차량의 환경을 의미한다.

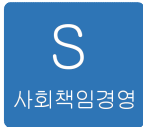
ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황



- ◎ 판교사옥 친환경 자재 사용, 지열회수 시스템 등 구축(녹색건축 인증)



- ◎ 환경관리 전담조직(Culture Team) 보유
- ◎ 온실가스 배출량 집계 및 감축 전략 보유



- ◎ 인권영향평가 실시 등으로 임직원의 인권/안전 보호



- ◎ 임직원 역량강화를 위한 육성 전략 및 전사 교육 커리큘럼 수립



- ◎ 임직원 모두 윤리서약서를 작성하며, 기업 윤리강령 공개
- ◎ 협력사에 대한 공정거래 프로그램(위험평가, 업무회의제도 등) 운영

II. 시장 동향

차량용 반도체 수요 확대에 따른 수혜가 예상되는 팹리스 산업, 연구개발 역량이 핵심

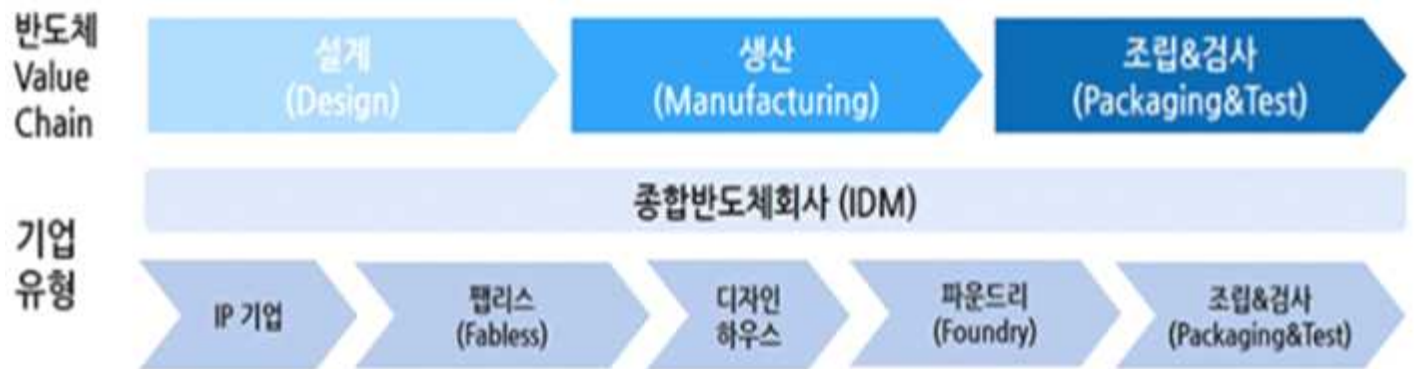
반도체 팹리스 업체는 반도체 제조 시설을 보유하고 있지 않아 비교적 낮은 리스크를 보유하고 있으나, 제품개발 역량이 중요하다. ADAS, 자율주행 등 기술의 발전에 따라 글로벌 비메모리 반도체 시장 및 차량용 반도체 시장의 지속적인 성장이 예상되는 바, 팹리스 업체의 고객 수요 확대가 예상된다.

■ 반도체 팹리스 산업의 특징 및 전망

반도체 산업을 영위하는 기업의 형태는 크게 1) 반도체 생산 과정을 종합적으로 갖춘 IDM, 2) 반도체 설계를 전문으로 수행하는 IP기업 3) 자사제품을 보유하고 있는 설계전문 팹리스, 4) 팹리스 기업이 설계한 도면을 제조공정에 맞춰 설계 등을 수행하는 디자인하우스, 5) 팹리스에서 설계한 반도체를 위탁생산하는 파운드리, 6) 반도체의 패키징 및 테스트를 수행하는 조립 및 테스트 (OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 업체로 구분된다.

구체적으로, 팹리스(Fabless)는 Fabrication과 Less의 합성어로 반도체의 설계 및 판매 등을 전문으로 수행하는 업체를 의미한다. 따라서, 반도체 팹리스 업체는 반도체를 제조할 수 있는 생산시설을 보유하고 있지 않으므로, 외부의 전문 위탁업체에게 제품의 생산의뢰를 맡기게 된다. 이를 통해 팹리스 회사는 제품개발 및 마케팅 등에 집중할 수 있으며, 설비투자 리스크, 원가관리 등에 비교적 자유로운 사업 구조를 지니고 있다. 다만 개발 인력을 바탕으로 핵심 원천기술 기반의 사업을 영위하고 있으므로, 비교적 높은 연구개발 역량이 요구된다.

[그림 2] 반도체 산업의 가치 사슬(Value Chain)



자료: 한국전자통신연구원, NICE디앤비 재구성

한편, 반도체는 메모리 반도체(Memory Semiconductor)와 비메모리(Non-Memory Semiconductor, 또는 시스템 반도체(System Semiconductor))로 구분된다. 메모리 반도체는 정보를 기억하고 저장하는 역할을 수행하며, 비메모리 반도체는 연산, 추론 등 정보를 처리하는 역할을 수행하는 반도체이다.

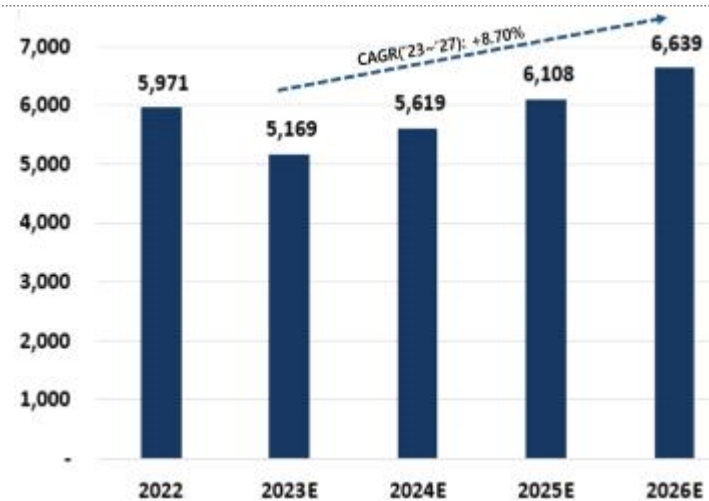
비메모리 반도체는 메모리 반도체 대비 비교적 범용성이 낮은 특징을 보이고 있다. 따라서, 고객사의 요청에 따른 각 소자별 용도 및 특성이 구체적이고, 다품종 소량생산의 구조를 지닌다. 또한, 메모리 반도체의 절대적 지향점으로 파악되는 고속, 고수율, 선풍 미세화 등이 비메모리 반도체에도 주요하게 작용하고 있으나, 자동차, 항공우주, 로봇 등 고신뢰성이 요구되는 등 비교적 차별화된 특징을 보이기도 한다. 이처럼, 비메모리 반도체의 제품개발 등을 수행하는 팹리스 회사는 고객사의 제품 성능 요구에 발맞춰 개발 단계부터 오랜 협력관계를 구축하여 꾸준한 연구개발을 수행하며 대응하는 것이 중요하다.

IT 및 통신 시장 분석 및 컨설팅 기관인 IDC(International Data Corporation)에 따르면, 글로벌 비메모리 반도체 시장은 2022년 대비 2023년 고물가, 고금리 등 대외환경의 어려움으로 소폭 하락해 2022년 5,971억 달러 수준에서 2023년 소폭 감소한 5,169억 달러 수준의 시장 규모를 달성할 것으로 예상되며, 이후 8.7% 수준으로 성장하여 연평균 6,639억 달러 수준의 시장 규모를 달성할 것으로 전망된다. 한편, [표 4]와 같이 ADAS, 자율주행 등 다양한 분야에 적용되는 제품 및 기술의 발전에 따라 차량용 반도체 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다. 시장조사기관 IHS에 따르면, 글로벌 차량용 반도체 시장은 2023년 760억 달러 수준에서 연평균 11.11% 성장하여 2027년 1,158억 달러 수준의 시장 규모가 추정된다.

이처럼, 비메모리 반도체 시장 및 차량용 반도체 시장은 대외환경의 개선에 따른 단기적인 성장세를 맞이할 것으로 예상되며, 중장기적 관점에서의 IT 기술 발전 및 전방산업의 수요 증가 등의 중장기적 성장 동력이 존재하고 있다. 이와 같이, 반도체 제조 산업의 확대와 함께 반도체 설계 수요의 확대가 예상되므로, 동사와 같은 팹리스 업체 또한 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

[그림 3] 글로벌 비메모리 반도체 시장 전망

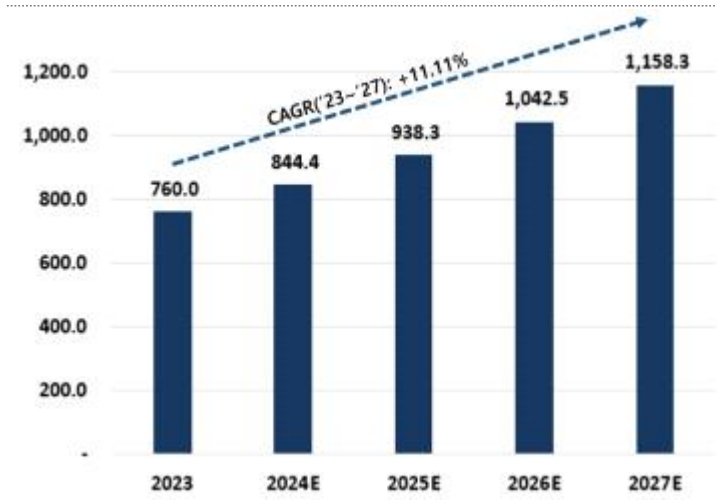
(단위: 억 달러)



자료: IDC(International Data Corporation), NICE디앤비 재구성

[그림 4] 글로벌 차량용 반도체 시장 전망

(단위: 억 달러)



자료: IHS, NICE디앤비 재구성

[표 4] 차량용 반도체의 종류 및 적용 분야

분야	적용부품
안전-ADAS	- TPMS(타이어공기압 경고 장치), 에어백, 추돌·차선이탈 경고, 주차 보조, 후방카메라, 서라운드 뷰 카메라, E-Mirror, In-Cabin ADAS 등
새시	- 제동장치, 조향장치, 트랙션 컨트롤, 서스펜션, 스마트 정션박스, 무선 충전 등
차체	- 내비게이션, 텔레매틱스 등
파워트레인	- 라이팅, 와이퍼, 선루프, 파워윈도우 등
기타	- 전력반도체(모터, 인버터, DC-DC 컨버터 등), BMS(배터리 관리 시스템), 계기판, 조명 등

자료: ETRI, 한국자동차연구원 산업동향, NICE디앤비 재구성

■ 경쟁사 분석

동사와 유사하게 반도체 팹리스 사업을 영위하고 있는 주요 경쟁사로는 ‘LX세미콘’, ‘어보브반도체’ 등이 있다.

LX세미콘의 경우 팹리스 기업으로 디스플레이 패널을 구동하는 핵심 부품의 설계, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. LX세미콘의 주요 제품은 패널을 구동하는 Drive-IC, T-Con 등으로 확인된다. 고객사의 요청에 맞춰 개발단계부터 고객사의 요구 사양 및 특성에 맞는 제품개발을 수행하며, TI사업부(TV, IT, Display) 및 MS사업부(Mobile Solution)의 조직을 바탕으로 영업을 수행하고 있다.

어보브반도체는 MCU를 설계, 생산하는 팹리스 업체로 핵심 제품은 가전용 MCU이고, 직접 판매 및 대리점을 통한 간접 판매를 통해 제품을 판매하고 있다.

[표 5] 국내 팹리스 경쟁사

(단위: 억 원)

회사명	구분	매출액			기본정보 및 특징(2023.12. 기준)
		2021	2022	2023	
텔레칩스 (동사)	차량용 반도체 설계	1364.1	1504.0	1,910.9	· 중견기업, 코스닥 상장(2004.12.) · 주요 사업: 디지털 미디어 프로세서, 모바일 TV 등 · K-IFRS 연결 기준
LX세미콘	반도체 시스템 IC 설계	18,988.4	21,193.4	19,014.4	· 대기업, 코스피 상장(2022.11.) · 주요 사업: 반도체 시스템 IC(Driver IC 등) · K-IFRS 연결 기준
어보브반도체	MCU 설계	1675.0	2,425.8	2,324.4	· 중견기업, 코스닥 상장(2009.06.) · 주요 사업: MCU 사업 부문(AS MCU, GP MCU 등) · K-IFRS 연결 기준

자료: 각 사 사업보고서(2023.12.), NICE디앤비 재구성

III. 기술분석

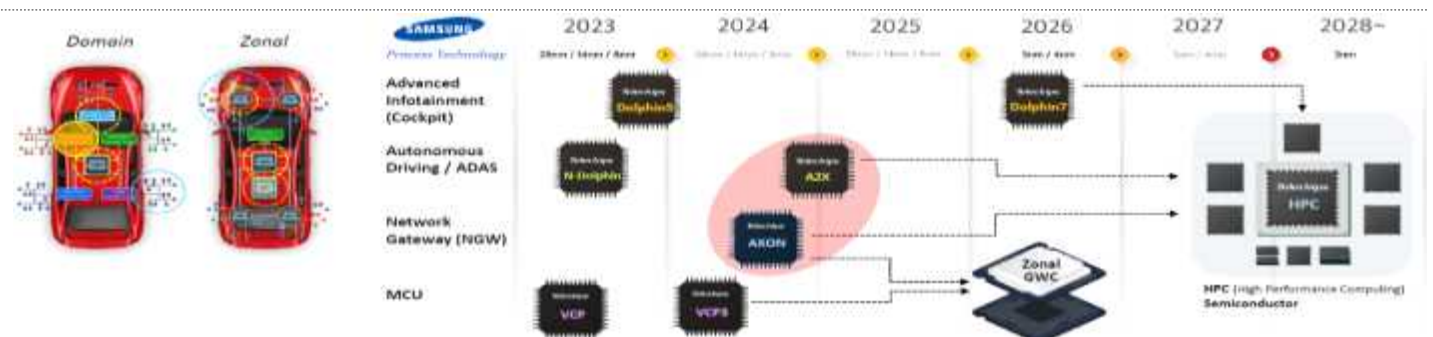
매출액 대비 높은 연구개발비용 기반 인포테인먼트 AP, ADAS 제품경쟁력 보유

동사는 2023년 기준 매출액 대비 34.3% 수준의 연구개발비를 지출하는 등 높은 수준으로 개발비를 지출하고 있다. 핵심 제품은 차량용 인포테인먼트 AP 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 프로세서 등이며 반도체 설계자산(IP) 업체 및 디자인하우스와의 협업으로 설계역량을 강화하고 있다.

■ 동사의 주요 제품 및 특징

동사는 신뢰성 개선, 사이버 보안, 기능적 안전성 보완, 저전력 디자인, SDV 솔루션 최적화 등의 연구개발 목표를 바탕으로 인포테인먼트용 AP 등 고객 맞춤형 제품을 생산하고 있다. 동사의 주요 제품군은 디지털 미디어 기기에 적용되는 각종 AP에 해당하는 DSP, 모바일 TV 수신칩 등이 존재한다. 또한, 차량용 반도체의 구조는 기존 분산된 아키텍처에서 도메인 기반 설계(Domain Based Architecture)로 발전하였고, 보다 중앙집권적인 이점을 보유한 영역별 설계(Zonal Based Architecture)로 수행되고 있다. 동사도 이에 발맞춰 차량용 반도체 구조 고도화 대응을 위한 기술 및 제품 개발을 수행하고 있다.

[그림 5] 동사의 제품 및 연구개발 방향



자료: 동사 IR자료, NICE디앤비 재구성

▶ 차량용 인포테인먼트(IVI, In-Vehicle Infotainment) AP

차량용 인포테인먼트 등에 활용되는 IVI AP의 경우 AVN(Audio, Video, Navigation), Digital Cluster 및 Cockpit용 AP 제품으로, 현대차의 표준형 인포테인먼트 플랫폼에 적용된 돌핀 플러스(Dolphin+) 및 2025년 말 콘텐츠탈향 Smart Cockpit에 적용 예정인 돌핀3(Dolphin3) 제품이 대표적이다. 동사는 돌핀(Dolphin) 시리즈를 바탕으로 고객 수요에 대응하고 있으며, CES 2024에서 8나노미터 공정을 통해 제조하는 것으로 알려진 돌핀(Dolphin5)을 공개하였다.

[그림 6] 동사의 돌핀5(Dolphin5) 및 용도



자료: 동사 IR자료, NICE디앤비 재구성

▶ 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) 프로세서

첨단 운전자 보조 시스템에 활용되는 TCC75xx 제품군의 경우 1) 다기능 카메라(MFC, Multi-Function Camera), 2) 운전자 모니터링 시스템(DMS, Driver Monitoring System), 3) 카메라 미러 시스템(Camera Mirror System) 등의 기능을 보유한 자동차용 비전 프로세서이다. 이를 통해 운전자 머리의 위치, 각도, 시선 처리, 외부 차량 및 행인 등의 정보를 파악하여 운전자의 판단에 도움을 줘 차량의 안전성과 편의성을 향상시키고 있다. 동사는 또한 NPU(Neural Processing Unit, 신경망 처리 장치)를 적용한 고성능 비전 프로세서인 엔돌핀(N-Dolphin)의 필드 테스트 등을 수행하고 있다.

[그림 7] 동사의 N-돌핀(N-Dolphin) 및 용도



자료: 동사 IR자료, NICE디앤비 재구성

■ IP업체 등과의 협업으로 설계역량 강화

동사는 사피온, 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어 등 다양한 반도체 설계자산(Intellectual Property)을 보유한 IP 업체와의 협업을 수행하고 있으며, 최근 사피온의 NPU IP 공급을 바탕으로 AI 가속기 제품 관련 연구 개발을 수행하는 등 고객 수요에 대응할 수 있는 다양한 제품 포트폴리오 확장을 준비하고 있다. 또한, 가온칩스 등 디자인하우스 업체 등과의 협력으로 설계 역량을 강화하고 있다.

■ 동사의 연구개발 역량

동사는 R&D Division(연구본부) 2개의 연구소(Platform SW 연구소 및 시스템 반도체 연구소)를 보유하고 있고, 하부 연구 그룹 조직을 통해 연구개발을 수행하고 있다. 2023년 기준 매출액 대비 34.3%의 연구개발비용을 지출하는 등 높은 수준의 연구개발 투자를 수행하고 있는 것으로 파악된다.

[표 6] 동사의 연구개발비용

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023
연구개발비용	467.3	652.2	655.5
연구개발비 / 매출액 비율	34.3	43.4	34.3

자료: 동사 사업보고서(2023.12.), NICE디앤비 재구성

[표 7] 동사의 연구개발 현황

연구과제명	연구내용 및 기대효과
ARM-Cortex-R5 코어, Program Flash, SRAM, Ethernet, HSM을 내장한 저전력 Micro Controller Unit(MCU) 개발	<ul style="list-style-type: none"> - 28nm 공정을 이용한 저전력/초소형 제품 - Safety 기능 및 신뢰성 기능 강화
VPU, GPU, ARM-Cortex-A72 Quad, ISP 코어를 내장한 고성능, 저전력 Digital Multi-Media Processor 개발	<ul style="list-style-type: none"> - 14nm 공정을 활용한 저전력/초소형 제품 - 고성능 CPU, GPU, VPU 프로세싱 기능 강화 - Multi-Display, Camera 지원 강화
CAN, ARM9 코어를 내장한 Digital Multi-Media Processor 개발	<ul style="list-style-type: none"> - 45nm 공정을 이용한 저전력 설계 제품 - 정지영상/동영상 처리 기능 탑재
VPU, GPU, ARM-Cortex-A53 Quad 1.5 GHz 코어를 내장한 고성능, 저전력 Digital Multi-Media Processor 개발	<ul style="list-style-type: none"> - 28nm 공정을 이용한 저전력/초소형 제품 - 고성능 그래픽(2D/3D), 동영상, 초고해상도(UHD) 이미지 처리기능 강화
WIFI, ARM9 코어를 내장한 Network Processor 개발	<ul style="list-style-type: none"> - ARM9 코어를 기반으로 Wifi를 지원하는 Wifi basedband SoC - 저전력/초소형 특징 보유
CAN, ARM9 코어를 내장한 Digital Multi-Media Processor 개발	<ul style="list-style-type: none"> - 65nm 공정을 이용한 저전력 설계 제품 - 정지영상/동영상 처리 기능 보유

자료: 동사 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

IV. 재무분석

자동차용 반도체 수요 확대에 따른 수혜로 양호한 성장세와 수익성 유지

차량용 인포테인먼트 시장 성장에 따라 국내 및 해외로 공급하는 반도체 물량이 늘어나면서 최근 3개년 간 꾸준한 매출 성장을 나타내었고, 양호한 수익구조를 지속하였다.

■ 해외 고객사 확대 및 고부가가치 반도체로 제품군 다변화하여 매출 성장세 지속

동사는 차량용 반도체 수급 문제의 반사효과로 2021년 1,364.1억 원(+35.4%, YoY)의 매출액을 기록하며 외형 성장을 나타낸 이후, 차량용 인포테인먼트 시장 성장에 따른 수요 증대로 2022년에는 1,504.0억 원(+10.3%, YoY)을 기록하였다. 2023년에는 세계적인 반도체 침체에도 불구하고 고객사를 일본과 동남아시아 등으로 확대하고 고부가가치 반도체로 제품군을 다변화하면서 1,910.9억 원(+27.1%, YoY)의 매출액을 기록하며 실적 성장세를 지속하였다.

한편, 2024년 1분기에는 전년 동기와 유사한 453.8억 원(-1.1%, YoY)의 매출을 기록하였다.

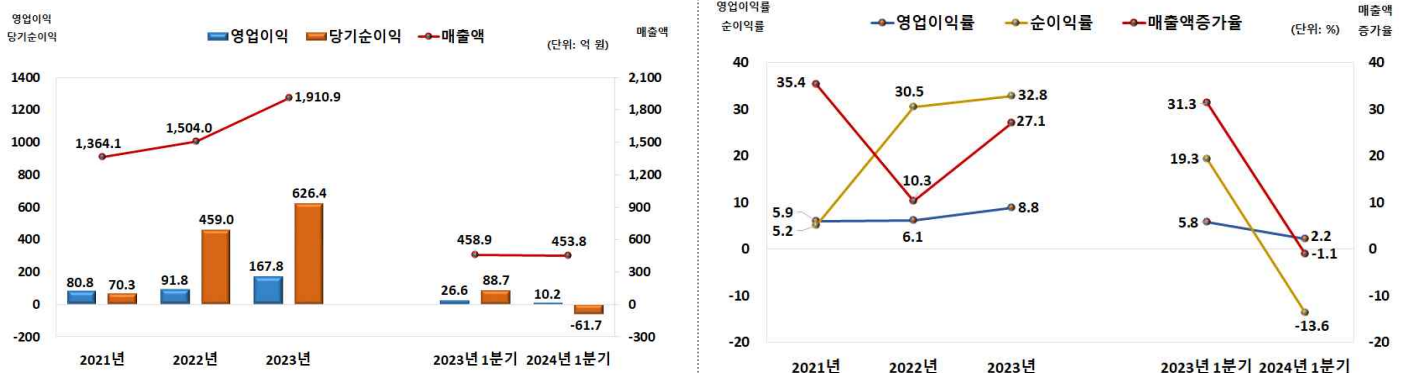
■ 최근 3개년 외형 성장에 힘입어 영업수익성 개선세

2021년 5.9%, 2022년 6.1%의 영업이익률을 기록하며 수익성 개선세를 보인 가운데, 2023년 원가율이 전년 62.4%에서 57.9%로 완화되어 전년 동기 대비 2.7%p 증가한 8.8%의 양호한 영업이익률을 기록하였다. 순이익의 경우 칩스앤미디어 보유 지분에 대한 평가 이익의 영향으로 2022년 459.0억 원, 2023년 626.4억 원으로 영업이익 규모를 크게 상회하는 순이익을 나타내었다.

한편, 2024년 1분기 매출액은 전년 동기와 유사한 수준이었지만, R&D 투자 확대 및 해외 프로모션 확대 등에 따른 비용 증가로 영업수익성이 약화되어 전년 동기 대비 크게 감소한 10.2억 원의 영업이익(영업이익률 2.2%)을 기록하였다. 또한, 칩스앤미디어 보유 지분 평가 손실 발생으로 인하여 61.7억 원의 순손실을 기록하며 순손익은 적자로 전환되었다.

[그림 8] 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

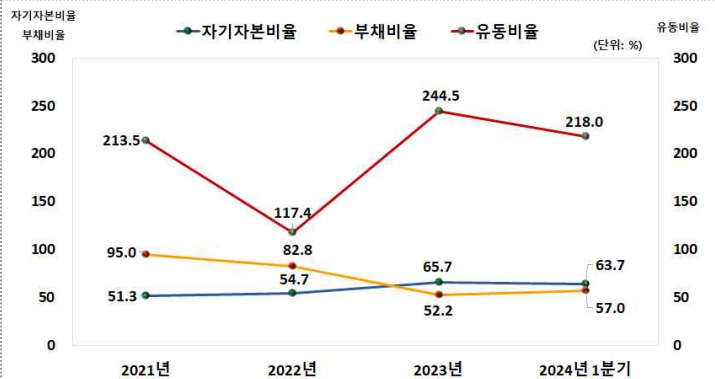
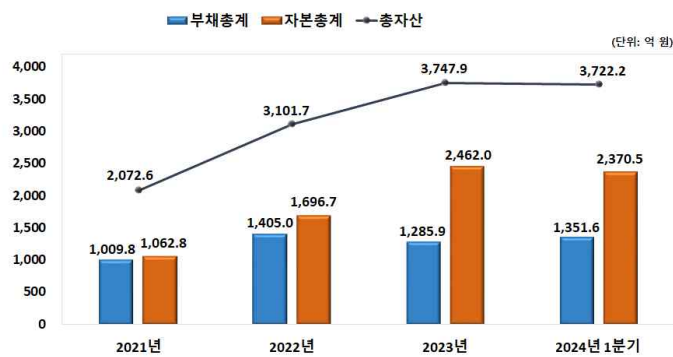
■ 주요 재무안정성 지표 양호한 수준

지속적인 순이익의 내부유보로 안정적인 자기자본을 확충하고 있으며, 총부채 규모 또한 자산 등 외형 대비 낮은 수준으로 유지되고 있어, 최근 3개년간 각각 95.0%, 82.8%, 52.2%의 부채비율을 기록하며 개선세를 나타내며 양호한 수준을 기록하였다. 특히 2023년에는 전환사채 200억 원 가량이 전환 청구되어 자기자본이 확대된 바, 부채비율이 전년 82.8%에서 52.2%로 크게 개선되었다. 2024년 1분기에는 결손금 발생에 따라 자기자본 규모가 축소되었으나 부채 규모도 확대되었으나, 여전히 57.0%의 양호한 부채비율을 나타내었다.

한편, 최근 3개년간 유동비율도 각각 213.5%, 117.4%, 244.5%로 등락세를 나타냈지만 안정적인 수준을 유지하였으며, 2024년 1분기 유동비율도 218.0%를 기록하며 양호한 유동성을 기록하였다.

[그림 9] 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

[표 8] 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021년	2022년	2023년	2023년 1분기	2024년 1분기
매출액	1,364.1	1,504.0	1,910.9	458.9	453.8
매출액증가율(%)	35.4	10.3	27.1	31.3	-1.1
영업이익	80.8	91.8	167.8	26.6	10.2
영업이익률(%)	5.9	6.1	8.8	5.8	2.2
순이익	70.3	459.0	626.4	88.7	-61.7
순이익률(%)	5.2	30.5	32.8	19.3	-13.6
부채총계	1,009.8	1,405.0	1,285.9	1,193.4	1,351.6
자본총계	1,062.8	1,696.7	2,462.0	1,767.8	2,370.5
총자산	2,072.6	3,101.7	3,747.9	2,961.2	3,722.2
유동비율(%)	213.5	117.4	244.5	124.0	218.0
부채비율(%)	95.0	82.8	52.2	67.5	57.0
자기자본비율(%)	51.3	54.7	65.7	59.7	63.7
영업현금흐름	127.4	-73.3	78.3	-26.5	-70.5
투자현금흐름	-257.6	-633.8	-288.2	18.1	-36.3
재무현금흐름	275.2	630.3	250.5	3.4	120.6
기말 현금	198.7	121.2	161.5	116.4	177.4

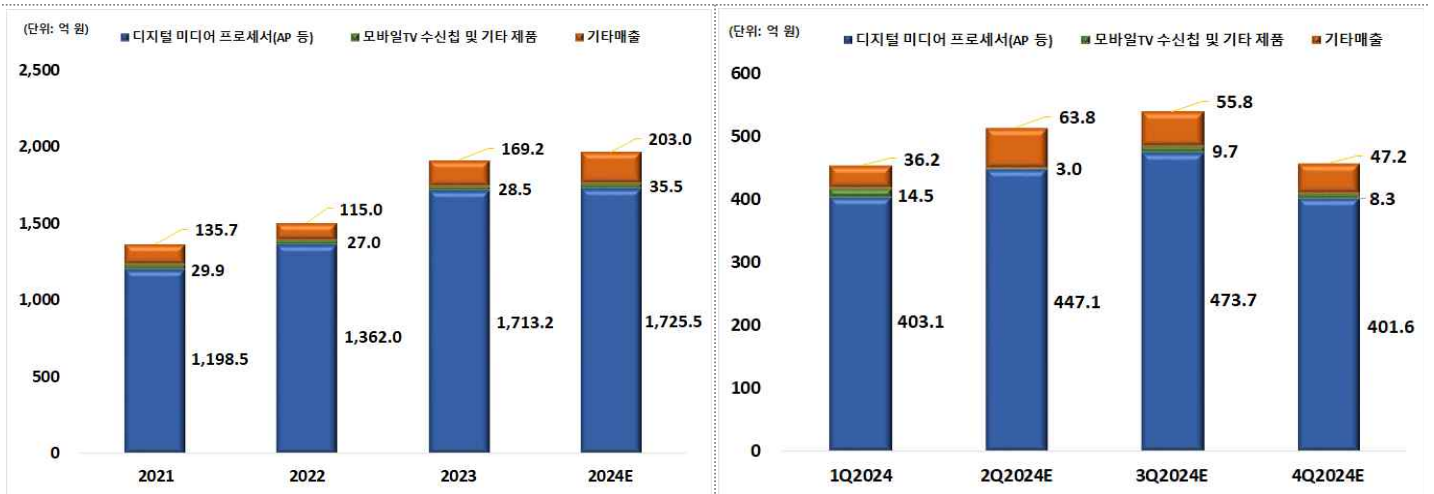
자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.03.)

■ 동사 실적 전망

동사는 최근 3개년 간 고부가가치 제품의 개발 및 해외 매출 비중 확대 전략 등에 힘입어 지속적인 외형성장세를 보였다. 동사는 주요 제품인 돌핀 시리즈 신제품(Dolphin5, Dolphin7, N-Dolphin 등)을 지속적으로 개발하며 제품 경쟁력을 제고하고 있으며, 차량용 인포테인먼트 시장 성장세 등을 고려 시, 2024년 동사의 매출은 전년에 이어 성장추이를 이어갈 것으로 전망된다.

[그림 10] 동사의 사업부문별 실적 및 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

[표 9] 동사의 사업부문별 연간 실적 및 분기별 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2024E	1Q2024	2Q2024E	3Q2024E	4Q2024E
매출액	1,364.1	1,504.0	1,910.9	1,964.0	453.8	513.9	539.2	457.1
디지털 미디어 프로세서(AP 등)	1,198.5	1,362.0	1,713.2	1,725.5	403.1	447.1	473.7	401.6
모바일TV 수신칩 및 기타 제품	29.9	27.0	28.5	35.5	14.5	3.0	9.7	8.3
기타 매출	135.7	115.0	169.2	203.0	36.2	63.8	55.8	47.2

자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.03.), NICE디앤비 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

해외 진출 확대를 위한 전략 수립 및 시장에 발맞춘 제품 연구개발 수행

동사는 해외 매출 신장을 위한 노력을 지속하고 있으며, 지역 별 해외법인을 바탕으로 해외매출을 확대하고 있는 한편 시장 요구에 대응하는 제품 연구개발을 적극적으로 수행하고 있다.

■ 제품 경쟁력 기반, 해외시장 진출 확대 기대

동사는 해외 고객확보 및 서비스 대응 등을 위해 텔레칩스 홍콩, 미국, 상해, 심천 등에 설립한 지역 별 해외법인을 바탕으로 해외 매출 확대 전략을 추진하고 있다. 특히, 2020년 이후 일본향 매출 증가로 해외 매출비중이 2020년 31.7%, 2021년 36.5%, 2022년 34.8%을 기록해 30%대 초·중반으로 증가하면서 외형 성장세를 이어갔다. 또한, 글로벌 부품사를 통해 일본, 중국, 동남아향 매출도 확대되었으며, 2024년은 유럽 글로벌 OEM Digital Cluster 양산, 글로벌 Tier1 Cockpit 양산 등을 통해 해외 매출 비중을 지속적으로 확대할 계획으로 파악된다.

또한, 동사는 진보된 인포테인먼트, ADAS, 자율주행, MCU 분야에서 제품 혁신을 이뤄내기 위한 연구개발을 계속하고 있으며, 최근 협력업체 사피온의 NPU IP 공급을 바탕으로 자율주행차량용 AI 가속기 제품 ‘A2X(X330)’ 관련 연구개발을 통해 기존 제품보다 연산 능력 및 전력 효율을 향상시키는 등 자율주행차 시장 요구에 대응하고 있다.

[그림 11] 동사의 글로벌 시장 성장 동력 및 목표



자료: 동사IR 자료, NICE디앤비 재구성

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
-	-	-	-
투자의견 없음			

시장정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2024.08.01.)

최근 6개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
텔레칩스	X	X	X